

## 陶氏電子材料推出應用在電路板的金屬化及影像轉移新產品

### 創造更輕巧、更環保、更具價格競爭力的消費性電子產品

台灣大園，2009年10月27日訊 — [陶氏電子材料](#)日前在 [TPCA 展覽](#) 及 [IMPACT 論壇](#)推出了應用於印刷電路板(PCB)的金屬化及影像轉移製程的新產品。這些新產品可為 PCB 產業帶來高性能、環保和成本效益高的解決方案，以回應目前消費性電子產品領域更輕巧、更環保、性能更佳、更具價格競爭力的發展趨勢。

- **PCB 電鍍銅**— [MICROFILL™ EVF 填孔技術](#) 可以提高鍍銅能力，使表面厚度較薄，並可同時進行通孔鍍銅。這種技術既適用於高密度互連(HDI)電路板，也適用於積體電路(IC)封裝載板。該公司頃於 IMPACT 論壇獲頒此一領域之傑出論文獎。[COOPER GLEAM™ HV-101 和 HVS-202 酸性鍍銅](#)提供高電鍍效率，可提升垂直連續式鍍銅線的產能，並降低鍍銅成本。[COPPER GLEAM™ MV-100 酸性鍍銅](#)在垂直連續式鍍銅設備上顯示出異常優異的電鍍均勻度和性能表現，可大幅減少電鍍時間。
- **PCB 通孔金屬化**— [CIRCUPOSIT™ 3350-1 化學沉銅](#)應用於 MLB（多層電路板）和 HDI，它具有優異的化學沉銅覆蓋力和可靠性，製程穩定，並可減低化學品之使用量和廢液產生量。[CIRCUPOSIT™ 7800 半加成製程除膠渣產品](#)可提供均勻穩定的高結合力的處理程序以及清潔可靠的盲孔底部。此外，它具有高抗撕強度、高可靠性、並可助後續化學沉銅達到優異的覆蓋力。**先進膨鬆劑產品** (Advanced Sweller) 為低濃度、低毒性溶劑，可為普通和高性能板材提供成本效益高、操作範圍寬的除膠渣製程解決方案。[CIRCUPOSIT™ 3323A 整孔劑](#)是應用於通孔電鍍製程的可生物分解的整孔劑，其優異的覆蓋力和較低的表面張力提供優異的性能和可靠性。
- **PCB 表面處理**— [PALLAMERSE™ SMT 2000 化學沉鎳](#)在化學鎳鈀金(ENEPIG)製程中為零件組裝提供穩定鍍層與高焊點可靠性的表面處理。**低金化學沉金產品**(Low Gold Immersion Gold)可以在化學鎳金製程(ENIG)中提供極低的金鹽濃度，大量節省金鹽損耗，同時維持均勻的金層厚度分佈和可靠的可焊性。
- **PCB 影像轉移**— [EAGLE™ 2100 光阻劑](#)是最新的立體負型電著光阻，適用於多種板材尺寸和立體幾何形狀，可提供均勻、無缺陷的鍍層和優異的解析度。
- **新近研發的新產品**包括先進半加成製程金屬化產品以及 [CIRCUPOSIT™ 71 全化學沉銅產品](#)，預計在明年上市。



“陶氏電子材料的優勢在於與業界領先的客戶密切合作來研發新一代的材料”，陶氏電子材料的全球總經理 Bob Ferguson 先生說，“作為金屬化技術的領導者，我們很高興地向 PCB 產業介紹我們高性能、低成本和環保的解決方案。陶氏電子材料擁有尖端的技術、優秀的顧客服務、強有力的技術支援和全球化的佈局，我們一直致力於為日新月異的電子世界提供可持續發展的技術”，他說。

®™ 為陶氏化學公司（陶氏）或其附屬公司的商標。

## 關於陶氏

陶氏是一家多元的化學公司，運用科學、技術以及“人元素”的力量不斷改進推動人類進步的基本要素。陶氏為全球約 160 個國家和地區的客戶提供種類繁多的產品及服務，並將可持續發展的原則貫徹於化學和創新，使客戶能為各消費市場提供更加優質的產品，包括純水、食品、藥品、油漆、包裝，以及個人護理產品。2008 年銷售額達 575 億美元，在全球擁有 46,000 名員工。陶氏在全球 35 個國家擁有 150 個生產基地，生產 3300 餘種產品。2009 年 4 月 1 日，陶氏收購全球領先的特殊材料製造商羅門哈斯公司（Rohm and Haas Company）。羅門哈斯 2008 年銷售額達 100 億美元，在全球 30 個國家擁有 98 個生產基地，15000 名員工。除特別注明外，“陶氏”或“公司”均是指陶氏化學公司及其附屬公司。有關陶氏的進一步資料，請流覽陶氏網頁 [www.dow.com](http://www.dow.com)。

## 關於陶氏電子材料

陶氏電子材料是全球電子產業的材料和技術供應商，引領半導體、[電子互連](#)、[表面處理](#)、[太陽能電池](#)、顯示器、LED 和光學產品領域的發展。透過分佈在世界各地的技術中心，陶氏優秀的研發科學家和應用專家與客戶密切合作，為新一代的電子技術提供解決方案、產品和技術服務。這種緊密的合作關係激發了陶氏的創新發明能力，其關鍵的終端應用領域涵蓋了廣泛的消費性電子產品，包括個人電腦、電視、行動電話、全球定位系統、車輛安全系統和航空電子設備等。

## 媒體聯絡：

陶氏電子材料  
謝嘉雯

電話：+886-37-539158  
電郵：[elysiahsieh@rohmmaas.com](mailto:elysiahsieh@rohmmaas.com)